

## DSPACK をご使用になる前に

1. 本製品はシステムでの開発または評価での使用を想定したものです。また国内の使用に際して電気用品安全法および電磁波障害対策の適用を受けておりません。開発および評価用のソケットとしてご使用下さい。
2. DSPACK は振動および衝撃環境にはご使用になれません。
3. DSPACK をケースから取り出す時は本体を押さえてからクッションを先に取り出して、ピン曲がりや折れにご注意下さい。
4. ケースを 50 以上の場所に長時間放置すると変形する場合がありますので、40 以下の直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
5. DSPACK は、構造上フラックス及び洗浄液がソケット内に残る為、フラックスの浸漬やフラックス洗浄は絶対に行わないで下さい。又、他の DIP 部品との併用においても DIP 部品側のフラックス等が DSPACK のガイドピン穴よりソケット内に入る恐れがありますので、フラックス洗浄は行わないで下さい。
6. DSPACK をターゲットボードにネジ止めする時、トルクドライバー等でネジを仮止め後、順次ネジを締めて下さい。ネジの締め付けトルク値の目安は、 $0.054\text{N}\cdot\text{m}$  ( $0.55\text{kgf}\cdot\text{cm}$ ) です。1ヶ所のみを強く締めると、接触不良の原因となることがあります。
7. DSPACK のトップカバーをネジ止めする時は添付の専用ドライバー(+)またはトルクドライバーでネジを仮止めした後に順次ネジを締めて下さい。ネジの締め付けトルクの目安は、 $0.054\text{N}\cdot\text{m}$  ( $0.55\text{kgf}\cdot\text{cm}$ ) です。1ヶ所のみを強く締めると、接触不良の原因となることがあります。
8. DSPACK 取り付けには、基板取り付け寸法図を参照願います。特に基板裏面のナットの箇所は配線禁止区域になりますのでご注意願います。
9. IC のハンダボールの表面が汚れ又は、酸化していると接触不良の原因となりますのでハンダボール表面の汚れや酸化膜を落としてから DSPACK に搭載して下さい。
10. システムの評価後に長時間放置する場合は、DSPACK のカバー側及び基板側のネジの締め付けを緩めることをお奨めします。